

2020-2026年中国半导体制造装备市场深度分析与投资战略报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国半导体制造装备市场深度分析与投资战略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202003/155523.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第1章：半导体制造装备行业发展综述	24
1.1 半导体制造装备行业定义及分类	24
1.1.1 行业概念及定义	24
1.1.2 行业主要产品大类	24
1.2 半导体制造装备行业统计标准	25
1.2.1 半导体制造装备行业统计部门和统计口径	25
1.2.2 半导体制造装备行业统计方法	25
1.2.3 半导体制造装备行业数据种类	25
1.3 半导体制造装备行业供应链分析	27
1.3.1 半导体制造装备行业上下游产业供应链简介	27
1.3.2 半导体制造装备行业主要下游产业链分析	28
(1) 消费电子行业现状与需求分析	28
(2) 计算机与外设市场发展现状与需求分析	30
(3) 网络通信行业现状与需求分析	31
(4) 汽车电子行业现状与需求分析	33
(5) 电子专用设备行业现状与需求分析	34
(6) 仪器仪表行业现状与需求分析	35
(7) LED显示行业现状与需求分析	36
(8) 电子照明行业现状与需求分析	37
1.3.3 半导体制造装备行业上游产业供应链分析	40
(1) 芯片市场发展分析	40
(2) 金属硅市场发展分析	41
(3) 铜材市场发展分析	41
(4) 塑封料市场发展状况分析	42
第2章：半导体制造装备行业发展现状及前景预测	44
2.1 中国半导体制造装备行业发展现状分析	44
2.1.1 中国半导体制造装备行业发展总体概况	44
2.1.2 中国半导体制造装备行业发展主要特点	45

2.1.3	2019年半导体制造装备行业规模及财务指标分析	45
(1)	2019年半导体制造装备行业市场规模分析	45
(2)	2019年半导体制造装备行业盈利能力分析	46
(3)	2019年半导体制造装备行业运营能力分析	47
(4)	2019年半导体制造装备行业偿债能力分析	47
(5)	2019年半导体制造装备行业发展能力分析	48
2.2	2012-2019年半导体制造装备行业经济指标分析	48
2.2.1	半导体制造装备行业主要经济效益影响因素	48
2.2.2	2012-2019年半导体制造装备行业经济指标分析	49
2.2.3	2012-2019年不同规模企业主要经济指标分析	50
2.2.4	2012-2019年不同性质企业主要经济指标分析	53
2.2.5	2012-2019年不同地区企业经济指标分析	55
2.3	2012-2019年半导体制造装备行业供需平衡分析	68
2.3.1	2012-2019年全国半导体制造装备行业供给情况分析	68
(1)	2012-2019年全国半导体制造装备行业总产值分析	68
(2)	2012-2019年全国半导体制造装备行业产成品分析	69
2.3.2	2012-2019年全国半导体制造装备行业需求情况分析	70
(1)	2012-2019年全国半导体制造装备行业销售产值分析	70
(2)	2012-2019年全国半导体制造装备行业销售收入分析	70
2.3.3	2012-2019年全国半导体制造装备行业产销率分析	71
2.4	2019年半导体制造装备行业运营状况分析	72
2.4.1	2019年行业产业规模分析	72
2.4.2	2019年行业资本/劳动密集度分析	74
2.4.3	2019年行业产销分析	77
2.4.4	2019年行业成本费用结构分析	79
2.4.5	2019年行业盈亏分析	82
2.5	2012-2019年12月半导体制造装备行业进出口市场分析	84
2.5.1	半导体制造装备行业进出口状况综述	84
2.5.2	半导体制造装备行业出口市场分析	85
(1)	2012-2019年半导体制造装备行业出口市场分析	85
1)	行业出口整体情况	85
2)	行业出口产品结构分析	86

- 3) 行业内外销比例分析87
 - (2) 2019年行业出口市场分析88
- 1) 行业出口整体状况88
- 2) 行业出口产品结构特征分析89
- 2.5.3 半导体制造装备行业进口市场分析90
 - (1) 2012-2019年半导体制造装备行业进口市场分析90
- 1) 行业进口整体情况90
- 2) 行业进口产品结构91
- 3) 国内市场内外供应比例分析92
 - (2) 2019年行业进口市场分析93
- 1) 行业进口整体状况93
- 2) 行业进口产品结构特征分析94
- 2.5.4 半导体制造装备行业进出口前景及建议95
 - (1) 半导体制造装备行业出口前景及建议95
 - (2) 半导体制造装备行业进口前景及建议96
- 2.6 2020-2026年中国半导体制造装备行业发展前景预测96
- 2.6.1 半导体制造装备行业发展的驱动因素分析96
 - (1) 市场空间较大，需求增长强劲96
 - (2) 下游产业的推动97
- 2.6.2 半导体制造装备行业发展的障碍因素分析97
 - (1) 产品结构待完善97
 - (2) 企业生产规模及所有制因素97
 - (3) 成本压力增大97
- 2.6.3 半导体制造装备行业发展趋势98
- 2.6.4 2020-2026年半导体制造装备行业发展前景预测98

第3章：半导体制造装备行业市场环境分析99

- 3.1 行业政策环境分析99
 - 3.1.1 行业相关政策动向99
 - (1) 《电子信息产业调整和振兴规划》99
 - (2) 2019年全国半导体照明电子行业标准100
 - (3) 《产业结构调整指导目录（2019年本）》100

(4) 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2019年度)》101

3.1.2 半导体制造装备行业发展规划101

3.2 行业经济环境分析102

3.2.1 国际宏观经济环境分析102

(1) 国际宏观经济走势分析102

(2) 国际宏观经济走势预测104

3.2.2 国内宏观经济环境分析107

(1) 国内宏观经济走势分析107

(2) 国内宏观经济走势预测111

3.2.3 行业宏观经济环境分析114

3.3 行业需求环境分析115

3.3.1 行业需求特征分析115

3.3.2 行业需求趋势分析116

3.4 行业贸易环境分析116

3.4.1 行业贸易环境发展现状116

3.4.2 行业贸易环境发展趋势118

3.5 行业社会环境分析120

3.5.1 行业发展与社会经济的协调120

3.5.2 行业发展的地区不平衡问题120

3.5.3 行业发展面临的环境保护问题121

第4章：半导体制造装备行业市场竞争状况分析125

4.1 行业总体市场竞争状况分析125

4.2 行业国际市场竞争状况分析125

4.2.1 国际半导体制造装备市场发展状况125

4.2.2 国际半导体制造装备市场竞争状况分析125

4.2.3 国际半导体制造装备市场发展趋势分析126

4.2.4 跨国公司在中国市场的投资布局126

(1) 日本厂商在华投资布局分析126

1) 东芝(TOSHIBA)126

2) 瑞萨(RENESAS)127

3) 罗姆(Rohm)127

- 4) 松下 (Panasonic) 127
- 5) 日本电气股份有限公司 (NEC) 128
- 6) 三肯 (Sanken) 129
- 7) 富士电机 (FujiElectric) 129
- 8) 三洋 (Sanyo) 129
- 9) 新电元 (ShindengenElectric) 130
- 10) 富士通 (Fujitsu) 130
- (2) 美国厂商在华投资布局分析131
 - 1) 威旭 (Vishay) 131
 - 2) 飞兆半导体 (FairchildSemiconductors) 131
 - 3) 国际整流器公司 (InternationalRectifier) 131
 - 4) 安森美 (OnSemiconductors) 132
- (3) 欧洲厂商在华投资布局分析132
 - 1) 飞利浦半导体 (PhilipsSemiconductors) 132
 - 2) 意法半导体 (STMicroelectronics) 133
 - 3) 英飞凌 (InfineonTechnologies) 133
- 4.2.5跨国公司在中国的竞争策略分析134
- 4.3行业国内市场竞争状况分析137
 - 4.3.1国内半导体制造装备行业竞争格局分析137
 - 4.3.2国内半导体制造装备行业集中度分析139
 - (1) 行业销售集中度分析139
 - (2) 行业利润集中度分析140
 - (3) 行业工业总产值集中度分析140
 - 4.3.3国内半导体制造装备行业市场规模分析141
 - 4.3.4国内半导体制造装备行业潜在威胁分析142
- 4.4行业不同经济类型企业特征分析143
 - 4.4.1不同经济类型企业特征情况143
 - 4.4.2行业经济类型集中度分析145
- 第5章：半导体制造装备行业主要产品分析147
 - 5.1行业主要产品结构特征147
 - 5.1.1行业产品结构特征分析147

5.1.2行业产品市场发展概况	147
(1) 产品市场概况及产量分析	147
(2) 产品发展趋势	148
5.2行业主要产品市场分析	149
5.2.1功率晶体管产品市场分析	149
5.2.2光电二极管产品市场分析	150
5.2.3普通二极管产品市场分析	150
5.2.4普通三极管产品市场分析	151
5.2.5其他分立器件产品市场分析	152
5.3行业主要产品技术与国外差距	153
5.3.1行业主要产品技术与国外的差距	153
5.3.2造成与国外产品差距的主要原因	153
5.4行业主要产品新技术发展趋势	154
5.4.1国际半导体分立器件新技术发展趋势	154
5.4.2国内半导体分立器件新技术发展趋势	155
第6章：半导体制造装备行业区域市场发展状况分析	156
6.1行业区域市场总体发展状况分析	156
6.1.1行业区域结构总体特征	156
6.1.2行业区域集中度分析	159
6.2行业重点区域产销情况分析	162
6.2.1华北地区半导体制造装备行业产销情况分析	162
(1) 2012-2019年北京市半导体制造装备行业产销情况分析	162
(2) 2012-2019年天津市半导体制造装备行业产销情况分析	164
(3) 2012-2019年河北省半导体制造装备行业产销情况分析	166
6.2.2东北地区半导体制造装备行业产销情况分析	168
(1) 2012-2019年辽宁省半导体制造装备行业产销情况分析	168
(2) 2012-2019年吉林省半导体制造装备行业产销情况分析	171
(3) 2012-2019年黑龙江省半导体制造装备行业产销情况分析	173
6.2.3华东地区半导体制造装备行业产销情况分析	176
(1) 2012-2019年上海市半导体制造装备行业产销情况分析	176
(2) 2012-2019年江苏省半导体制造装备行业产销情况分析	178

- (3) 2012-2019年浙江省半导体制造装备行业产销情况分析181
- (4) 2012-2019年山东省半导体制造装备行业产销情况分析183
- (5) 2012-2019年安徽省半导体制造装备行业产销情况分析186
- (6) 2012-2019年江西省半导体制造装备行业产销情况分析188
- (7) 2012-2019年福建省半导体制造装备行业产销情况分析190
- 6.2.4华中地区半导体制造装备行业产销情况分析192
 - (1) 2012-2019年湖北省半导体制造装备行业产销情况分析192
 - (2) 2012-2019年湖南省半导体制造装备行业产销情况分析195
 - (3) 2012-2019年河南省半导体制造装备行业产销情况分析197
- 6.2.5华南地区半导体制造装备行业产销情况分析199
 - (1) 2012-2019年广东省半导体制造装备行业产销情况分析199
 - (2) 2012-2019年广西半导体制造装备行业产销情况分析201
- 6.2.6其他地区半导体制造装备行业产销情况分析203
 - (1) 2012-2019年四川省半导体制造装备行业产销情况分析203
 - (2) 2012-2019年贵州省半导体制造装备行业产销情况分析205
 - (3) 2012-2019年陕西省半导体制造装备行业产销情况分析207

第7章：半导体制造装备行业主要企业生产经营分析210

7.1半导体制造装备商排名分析210

7.1.1半导体制造装备商工业总产值排名210

7.1.2半导体制造装备商销售收入排名211

7.1.3半导体制造装备商利润总额排名211

7.2半导体制造装备行业领先企业个案分析212

7.2.1深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析212

(1) 企业发展简况分析212

(2) 企业产销能力分析213

(3) 企业盈利能力分析213

(4) 企业运营能力分析214

7.2.2上海松下半导体有限公司经营情况分析216

(1) 企业发展简况分析216

(2) 企业产销能力分析217

(3) 企业盈利能力分析217

- (4) 企业运营能力分析218
- 7.2.3苏州松下半导体有限公司经营情况分析220
 - (1) 企业发展简况分析220
 - (2) 企业产销能力分析220
 - (3) 企业盈利能力分析221
 - (4) 企业运营能力分析222
- 7.2.4无锡华润华晶微电子有限公司经营情况分析224
 - (1) 企业发展简况分析224
 - (2) 企业产销能力分析224
 - (3) 企业盈利能力分析225
 - (4) 企业运营能力分析225
- 7.2.5恩智浦半导体广东有限公司经营情况分析228
 - (1) 企业发展简况分析228
 - (2) 企业产销能力分析228
 - (3) 企业盈利能力分析229
 - (4) 企业运营能力分析229

第8章：半导体制造装备行业投资分析及建议34

- 8.1半导体制造装备行业投资特性分析347
 - 8.1.1半导体制造装备行业进入壁垒分析347
 - (1) 技术壁垒347
 - (2) 资金壁垒347
 - (3) 人才壁垒347
 - (4) 行业认证壁垒348
 - 8.1.2半导体制造装备行业盈利模式分析348
 - 8.1.3半导体制造装备行业盈利因素分析348
 - (1) 市场需求持续增长，为半导体分立器件带来巨大市场空间348
 - (2) 国家战略需求及对半导体产业政策大力扶持349
- 8.2半导体制造装备行业投资兼并与重组整合分析350
 - 8.2.1半导体制造装备行业投资兼并与重组整合概况350
 - 8.2.2外资半导体制造装备企业投资兼并与重组整合350
 - 8.2.3国内半导体制造装备企业投资兼并与重组整合351

8.2.4	半导体制造装备行业投资兼并与重组动向	353
8.3	半导体制造装备行业投资风险	353
8.3.1	半导体制造装备行业政策风险	353
8.3.2	半导体制造装备行业技术风险	354
8.3.3	半导体制造装备行业宏观经济波动风险	354
8.3.4	半导体制造装备行业关联产业风险	354
8.3.5	半导体制造装备行业其他风险	355
8.4	半导体制造装备行业投资建议	355
8.4.1	半导体制造装备行业投资机会分析	355
8.4.2	半导体制造装备行业主要投资建议	356
	(1) 培育核心竞争力，建立国际品牌	356
	(2) 加快兼并和收购，尽快形成一批半导体分立器件行业的航母	356
	(3) 加强半导体分立器件企业之间的联系和合作	356

图表目录：

图表：	2019年半导体制造装备行业产销情况（单位：万元，%）	78
图表：	2019年半导体制造装备行业产销情况（按经济类型划分）（单位：万元，%）	78
图表：	2019年半导体制造装备行业产销情况（按重点地区划分）（单位：万元，%）	79
图表：	2019年半导体制造装备行业成本费用情况（单位：万元）	80
图表：	2019年半导体制造装备行业成本费用结构情况（单位：%）	80
图表：	2019年半导体制造装备行业成本费用情况（按经济类型划分）（单位：万元）	81
图表：	2019年半导体制造装备行业成本费用情况（按重点地区划分）（单位：万元）	82
图表：	2019年半导体制造装备行业盈亏情况（单位：万元，%）	82
图表：	2012-2019年半导体制造装备行业出口产品结构（单位：%）	87
图表：	2012-2019年中国半导体制造装备行业内外销比例（单位：%）	88
图表：	2019年半导体制造装备产品出口月度金额图（单位：亿美元）	88
图表：	2019年中国半导体制造装备行业出口产品（单位：万个，吨，万只，万美元）	89
图表：	2019年中国半导体制造装备行业出口产品结构（单位：%）	90
图表：	2012-2019年半导体制造装备行业产品进口月度金额走势图（单位：万美元）	91
图表：	2012-2019年中国半导体制造装备行业进口产品（单位：吨，万个，万只，万美元）	
图表：	2012-2019年半导体制造装备行业进口产品结构（单位：%）	92
图表：	2012-2019年中国半导体制造装备行业国内市场内外供应比例（单位：%）	93

图表：2012-2019年北京市半导体制造装备行业亏损情况变化趋势图（单位：万元，%）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202003/155523.html>